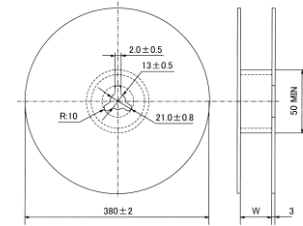
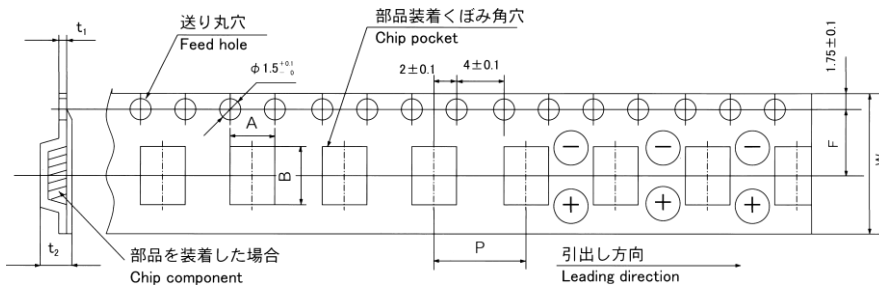


■ チップ形テーピング品 Chip Type Taping Specifications

● キャリアテープ仕様 Carrier Tape Dimensions



● 包装仕様 Packaging specifications



単位 unit: mm

ケースサイズ Case size	W ±0.3	A ±0.2	B ±0.2	P ±0.1	F ±0.1	t ₁ ±0.1	t ₂ ±0.2
4 x 5.4	12.0	4.7	4.7	8.0	5.5	0.4	5.7
4 x 5.8	12.0	4.7	4.7	8.0	5.5	0.4	6.3
5 x 5.4	12.0	5.7	5.7	12.0	5.5	0.4	5.7
5 x 5.8	12.0	5.7	5.7	12.0	5.5	0.4	6.4
6.3 x 5.4	16.0	7.0	7.0	12.0	7.5	0.4	5.7
6.3 x 5.8	16.0	7.0	7.0	12.0	7.5	0.4	6.4
6.3 x 7.7	16.0	7.0	7.0	12.0	7.5	0.4	8.2
8 x 6.2	16.0	8.7	8.7	12.0	7.5	0.4	6.8
8 x 10.2	24.0	8.7	8.7	16.0	11.5	0.4	11.0
10 x 10.2	24.0	10.7	10.7	16.0	11.5	0.4	11.0

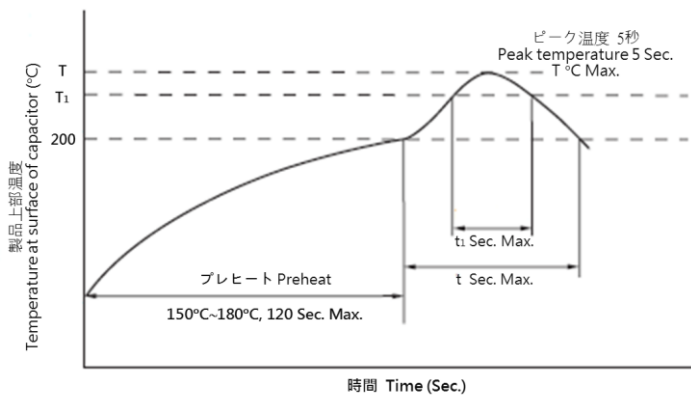
ケースサイズ Case size	W mm	収容数量 (個) リール/Reel (pcs)	収容数量 (個) 箱/Carton (pcs)	加工記号 Code
4 x 5.4	14	2,000	20,000	TR
4 x 5.8	14	2,000	20,000	
5 x 5.4	14	1,000	10,000	
5 x 5.8	14	1,000	10,000	
6.3 x 5.4	18	1,000	10,000	
6.3 x 5.8	18	1,000	10,000	
6.3 x 7.7	18	1,000	10,000	
8 x 6.2	18	1,000	10,000	
8 x 10.2	26	500	5,000	
10 x 10.2	26	500	5,000	

■ 鉛フリータイプリフロー許容条件 / Lead Free Type Reflow Soldering Condition

● ケースサイズφ4~φ10mm品 Size φ4~φ10

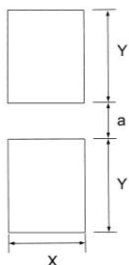
- コンデンサ表面温度がT℃以下である事。
Temperature at surface of capacitor shall not exceed T℃.
- コンデンサ表面温度は200℃以上の時間がt秒、T₁℃以上の時間がt₁秒を越えない事。
Period that temperature at the surface of capacitor becomes more than 200℃ and T₁℃ shall not exceed t and t₁ seconds.
- 予熱は150℃~180℃で120秒以内である事。
Preheat shall be made at 150℃~180℃ and for maximum 120 seconds.

サイズ Size	T℃	T ₁ ℃	t (sec.)	t ₁ (sec.)	リフロー回数 Reflow cycle
φ4~φ6.3	250	230	90	40	1
φ8	240	230	90	30	1
φ10	235	230	60	30	1



- ピーク温度 Peak temperature
 - 200℃を超える時間(Max.) Time more than 200℃
 - T₁を超える時間(Max.) Time more than T₁
- ※ 許容条件を越える場合は御相談ください。
Please contact us if the condition is over the maximum.

● 推奨ランドパターン / Recommended Land Size



ケースサイズ Case size	X	Y	a
4φ	1.6	2.6	1.0
5φ	1.6	3.0	1.4
6.3φ	1.6	3.5	2.1
8 x 6.2	2.5	4.0	2.1
8 x 10.2	2.5	3.5	3.0
10 x 10.2	2.5	4.0	4.0

● 印刷仕様 Marking

